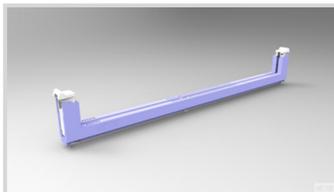




连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽



DRAM 类型: **双倍数据速率 (DDR) 3**

位数: 240

PCB 端接方法: **表面贴装**

模块方向: **垂直**

中心线 (间距) : 1 mm [.03 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 3

### 结构特性

托架数	2
钥匙数	1
行数	2
位数	240
模块方向	垂直

### 电气特征

DRAM 电压	1.5 V
---------	-------

### 主体特性

插销颜色	黑色
插销材料	热塑塑料
弹射器材料颜色	黑色
模块钥匙类型	左偏移
弹射器位置	两端
弹射器材料	热塑塑料
弹射器类型	旋转

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 $\mu\text{m}$ [100 $\mu\text{in}$ ]
插座种类	DIMM
端子接触部电镀材料	金 (Au)
内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.51 $\mu\text{m}$ [20 $\mu\text{in}$ ]

### 端接特性

插入种类	直接插针
PCB 端接方法	表面贴装

### 机械附件

安装角度	直角
PCB 安装固定类型	焊钉
接合对准类型	左偏移
接合对准	不带
PCB 安装固定	带有

### 壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	1 mm[.03 in]

### 尺寸

中心固定孔直径	2.45 mm[.096 in]
PCB 的外形高度	21 mm[.82 in]
行间距	1.45 mm[.05 in]

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	480
封装方法	硬托盘

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 该系列中的其他产品 | DDR3 DIMM



DIMM 插槽(9)

## 该系列中的其他产品 | DDR3 SO DIMM

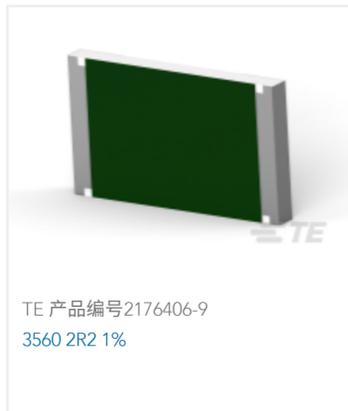
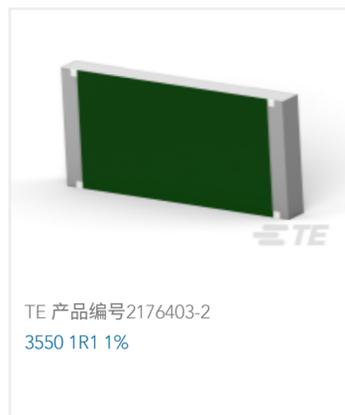


DIMM 插槽(9)



SO DIMM 插槽(3)

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

VLP DDR3 DIMM 240POS. 1.0PITCH

英文版本